

# 기술 정보 시스템 개발

\*용석균, 유병훈, 김용삼, 노호창

삼성전자 기술총괄 CAD CENTER

## 요 약

현대의 극심한 경쟁체제 속에서 제조업체의 생존 여부는, 얼마나 좋은 제품을 신속히 시장에 출시하느냐에 달려 있으며, 이러한 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발에 관련된 각종 정보의 부문간 공유 및 흐름의 제어가 그 성패의 관건이라 할 수 있다. 따라서 본 연구의 목적은 삼성전자의 제품 개발과정에서 발생되는 모든 기술정보를 효율적으로 관리할 수 있는 체계를 확립하고, 이 체계를 System적으로 구현하여 각종 기술 정보를 생성하고, 조회하는 개발자들의 현업에 이 System을 적용하고자 하는데 있다.

본 연구에 사용된 개발 Tool은 X-terminal과 HP EWS이었고, 실제 사용자들의 운용 기종은 선진 각국의 Server& Client 추세에 따라, DB Server로는 HP9000/865S를 채택하고, Client로는 HP EWS, X-terminal, PC386등의 기종을 적용하였다. 또한 개발언어는 'C'language를 사용하였고 DBMS는 IBM MIS와의 연계를 위해, Oracle을 이용하였다.

본 연구의 결과로써 나타나는 효과는, 외형적으로 각종 기술 정보의 공유로 인한 설계 품질 향상과 개발 납기 단축이라 할 수 있으며, 그 내면에 있는 개발 관련 각종자료 및 업무의 표준화와 도면관리System의 개발 기술확보 또한 중요한 성과라 할 수 있다.

## I . 서 론

기술정보시스템에서 관리하는 정보를 크게 분류하면, 기구 및 회로의 도면정보, BOM을 포함한 부품 정보, 각 부문에서 발생되는 기술 Document와 S/W관련 정보등이라 할 수 있으며, 이들 정보는 각각의 고유한 특성을 가짐과 동시에 제품을 매개로 하여 유기적인 관련성을 갖고 있다. 이러한 개발 정보들의 일관된 관리체계를 구축하기 위해 본 연구에서는, 당사내 표준코드 체계인 SEC-CODE를 근간으로 도면과 부품정보, 기술Document등을 연계 하였다.

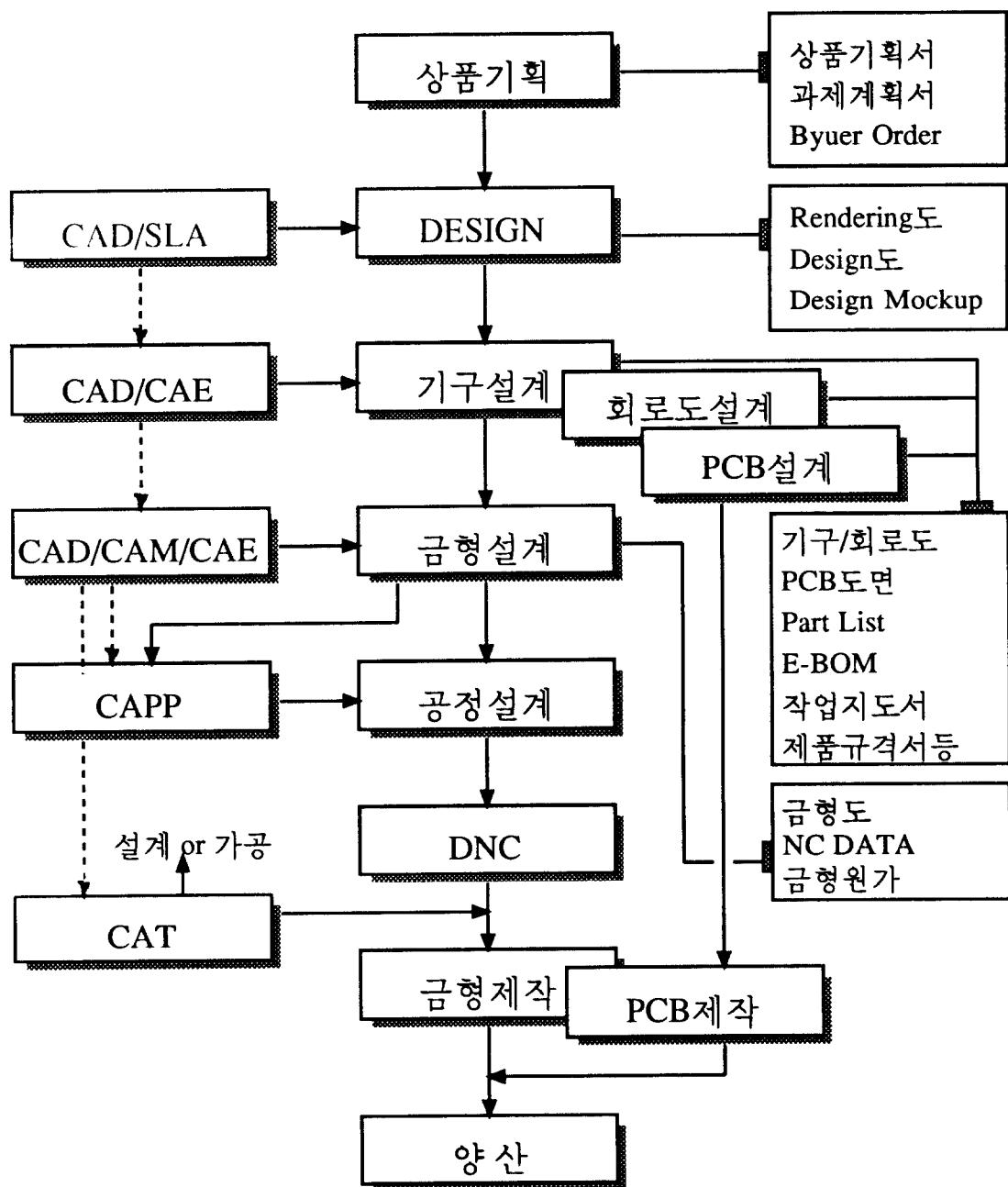
기술정보시스템의 핵심기능은 제품 개발 단계에서 필요한 각종 개발 정보를 생성하고, 조회하며, 관리하는 것이라 할 수 있으며, 이러한 3가지 Function의 구현 방법은 조회하고자 하는 형태에 따라 몇가지 Case로 나누어 질 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 당사의 제품 개발 업무Process를 최우선으로 고려한 조회 Rule을 정형화하여 표준안을 정립한 뒤, 이 안을 가지고 기술 정보시스템의 개발에 적용하였다.

## II . 본 론

당사의 실정에 적합한 기술정보 시스템을 개발하기 위해서는 사내 기술 정보의 분류 체계가 필요했고, 이들 분류 체계에 따른 각종 기술 Document의 표준화와 단순화가 시급한 선결 요건이었다. 이러한 여건에 따라 본 연구에서는 기술Document의 표준화와 병행하여, 개발work flow도 정형화시켜 양자 간의 관계를 가시화 함으로써, 기술정보 시스템을 기존의 독립적인 Utility의 성격에서 탈피시켜, 개발업무전체에 대한 전산화의 개념으로 시스템을 확장 코자 하였다.

## 1. 개발업무단계와 기술 Document

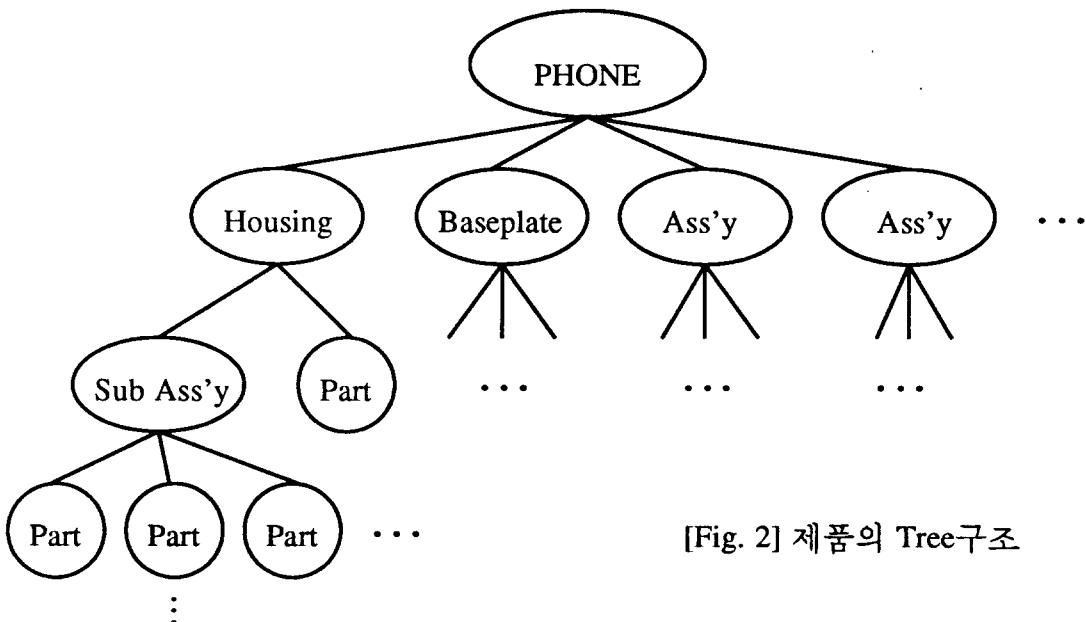
삼성전자의 개발work flow와 각 개발 단계에서 발생하는 기술 문서들의 관계를 간략하게 도식화하면 [Fig.1]과 같다.



[Fig. 1] 개발work flow와 기술Document

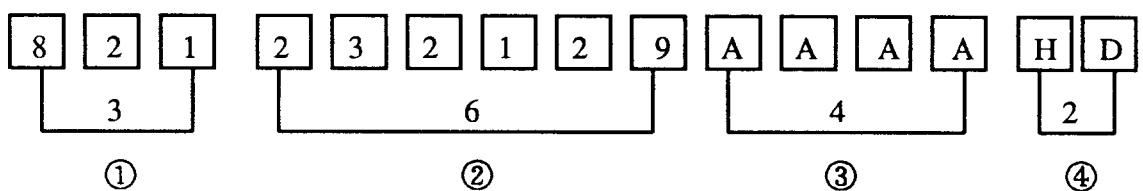
## 2. 부품과 SEC-CODE

[Fig. 1]과 같은 Work Flow를 거치게 되면 하나의 제품이 완성되는데, 이때 제품을 설계자의 관점에서 Tree구조로 전개한 것을 보통 설계BOM 혹은 E-BOM이라 말하며, 아래 그림과 같은 전개형식을 갖는다.



제품은 [Fig. 2]에서와 같이 Ass'y, Sub Ass'y, Part등으로 구성되며, 각각의 Part에 대한 정보가 모여 제품 정보를 형성하게 된다. 부품에 관한 정보의 종류는 서론에서 언급한 바와 같으며, 한 부품의 서로 다른 정보를 엮어주는 Key index로는 표준화된 Code체계를 이용하는 것이 가장 바람직하다.

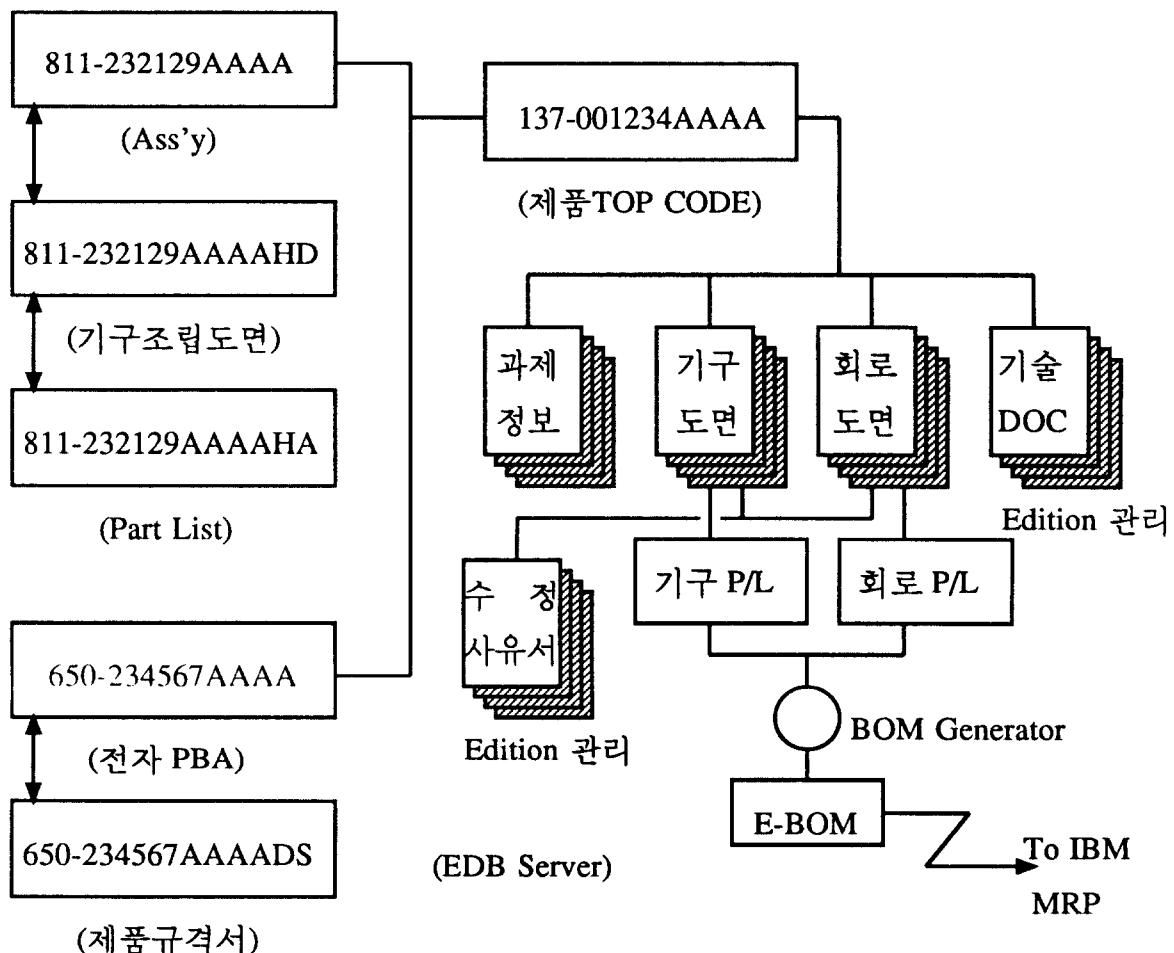
본 연구에 사용된 SEC-CODE의 경우 3- 6- 4- 2의 체계를 갖고 있으며, 하나의 부품코드를 가지고 부품의 실물, 도면, BOM, 관련규격서등의 문서류를 총체적으로 지칭할 수 있게끔 구성되어 있다.



[Fig. 3] SEC-CODE 체계

[Fig. 3]에서 SEC-CODE의 구조를 보여 주고 있는데, ①의 항목에 해당하는 것이 대분류코드로서 부품일 경우 기구,전자,전기,부자재등을 표시한다. ②의 항목에서 처음 2자리는 제품 구분을 표시하고, 4자는 Serial을 나타내며, ③의 항목은 부품일 경우 2자리를 사용하여 Version을 나타내고, 조립물일 경우 4자리를 사용한다. 이때 표시하고자 하는것이 부품또는 조립물의 실체일 경우 ①, ②, ③의 항목만을 이용하며, ④의 항목은 Document를 지칭하고자 할때 사용한다. ④의 항목은 보통 Document Type이라고 하며, HD일경우 기구도면을, EC는 회로도를, HA는 Part List를, DS는 제품 규격서를 나타내며, 알파벳의 조합으로 사내 모든 Document(정보)를 표현할 수 있다.

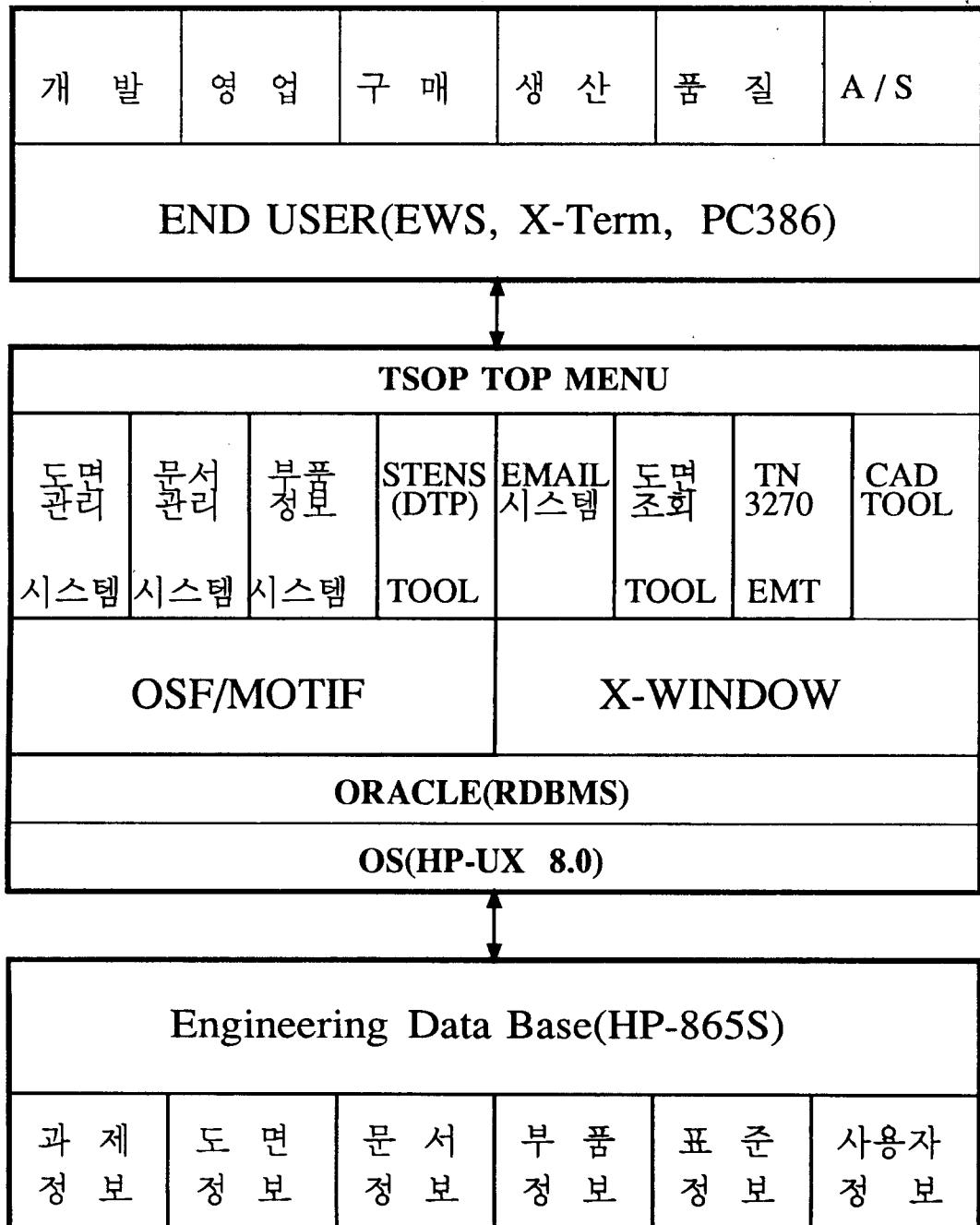
[Fig. 4]에 SEC-CODE를 매개로 하여 제품에 관련된 개발 정보가 어떻게 Integration되고 있는가를 보여주고 있다.



[Fig. 4] 제품개발정보와 SEC-CODE의 연계

### 3. 기술정보시스템의 S/W Platform

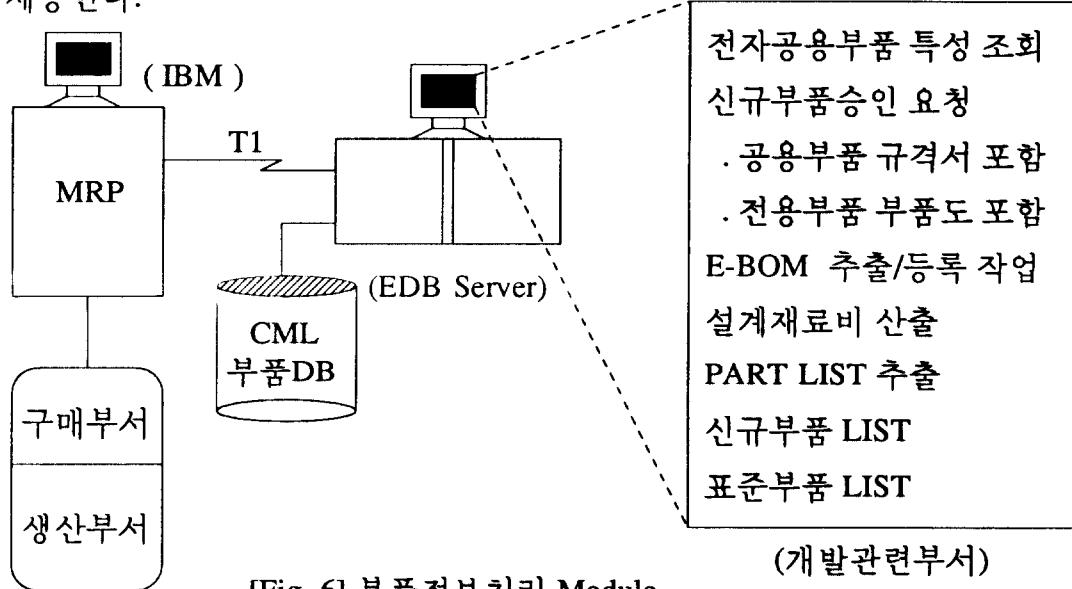
[Fig. 4]에서와 같은 제품개발 정보를 총체적으로 관리하기 위해 개발된 삼성전자 기술정보 시스템의 S/W Platform은 [Fig. 5]와 같으며, 사용자는 자신의 단말에서 경영, 개발에 관한 모든 정보를 볼 수 있게 구현 하는것이 기술정보 시스템 개발의 기본적인 개념이었다.



[Fig. 5] 기술정보시스템 S/W Platform

#### 4. 부품 정보 처리 MODULE

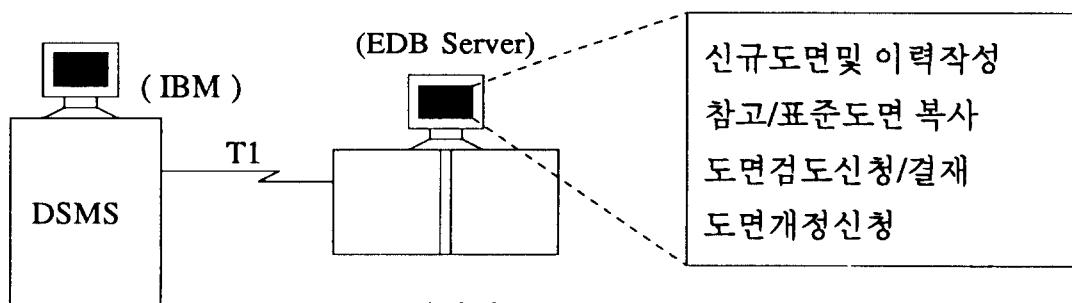
기술정보 시스템 사용자가 설계구상 단계부터 최종 시작품 제작 단계 까지 사용되는 각종 표준/공용 부품에 대한 정보를 조회하거나 부품 원가를 계산하고, 신규부품의 승인 및 BOM등록작업을 수행하는 Module이다. 설계전.후에 관련되는 공용또는 전용부품에 대한 조회, 신규부품 승인등록, BOM 작업, 부품의 사전원가 및 BOM Data 자동추출 기능등을 개발자에게 제공한다.



[Fig. 6] 부품정보처리 Module

#### 5. 도면 관리 MODULE

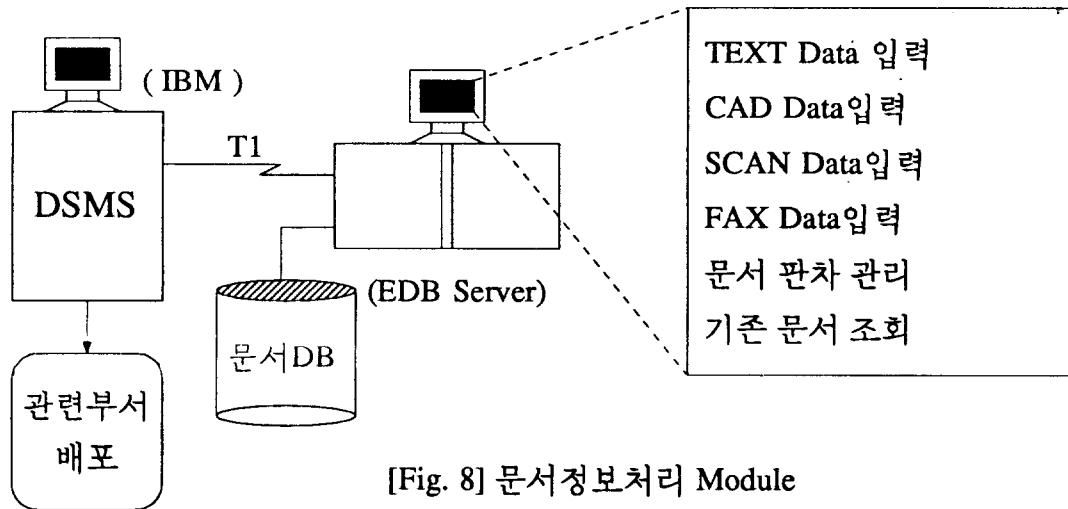
기술정보 시스템 사용자가 도면을 작성하거나 또는 작성한 도면의 검토 신청 및 결재를 On-Line상에서 처리할 수 있으며, 개발관련자간에 관련된 도면의 조회 및 의사소통이 시스템 상에서 용이하게 이루어지게끔 구성되어 있다. 또한 CAD Tool과 Data Base를 IPC로 I/F 하여 도면의 작성 및 수정에 대한 이력관리가 철저히 수행되며, 도면 조회시 화면의 내용을 Plotter, L-BP 또는 Dot Printer로 출력하는 기능을 갖고 있다.



[Fig. 7] 도면 관리 Module

## 6. 문서 처리 MODULE

설계 / 개발 업무에 수반되는 각종 기술문서나 DOC를 작성/조회, 관리하는데 이용하는 Module이다. 문서작성시 단순한 Text 뿐만아니라 IM-AGE나 HPGL등의 Data를 조합한 형태의 Document 편집처리도 가능하며, Postscript 방식을 이용하여 LBP나 DOT-Printer로 출력시킬 수 있다.

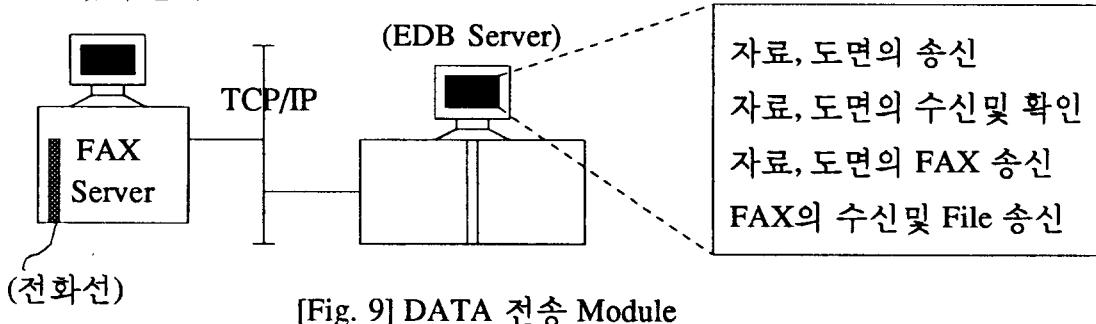


## 7. 표준 조회 MODULE

기술정보 시스템 사용자가 개발 업무 수행과 관련된 회사내 각종표준 및 규격, 설계 지침등의 정보를 조회하고자 할때 사용하는 Module이다.

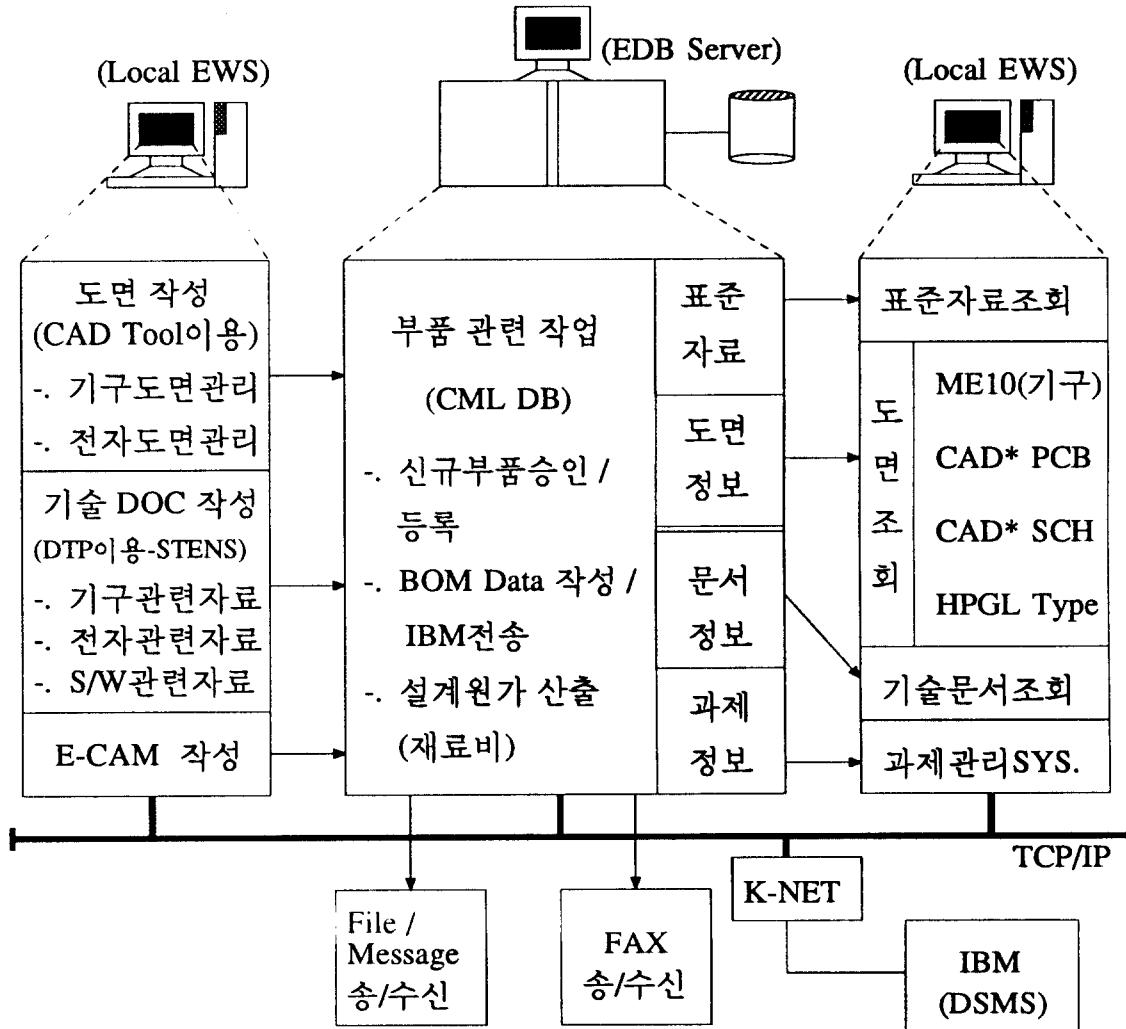
## 8. DATA 전송 (E-MAIL) MODULE

기술정보 시스템 사용자가 업무수행시 기술자료, 도면 또는 Message를 전달하거나, FAX를 주고 받는데 이용하는 Module로써, 전자우편 (E-Mail) 및 FAX 송,수신기능을 제공하여 사내외의 사용자간에 정보를 교환 할 수 있게 한다.



## 9. 기술정보 시스템의 Structure

앞서 설명한 기술정보 시스템의 각 Module을 Merge하여, 전체 구성을 도시해 보면 [Fig. 10]과 같으며, 결국 사용자는 [Fig. 10]과 같은 기능을 자신의 단말상에서 이용하여 개발관련 제반업무를 수행함을 알 수 있다.



[Fig. 10] 기술정보 시스템 Structure

## 10. HARDWARE & SOFTWARE Specification

기술정보 시스템의 H/W, S/W Specification은 다음과 같다.

### 10.1 H/W

10.1.1 DB Server : HP9000/865 series, Main Memory - 128MB  
HDD - 7.2GB

10.1.2 Client : HP EWS, X-terminal, PC-386

## 10.2 S/W

10.2.1 DBMS	: Oracle Ver 6.0.33.1.2
10.2.2 DB Network	: Oracle sql*NET (for HP & IBM)
10.2.3 DTP Tool	: STENS
10.2.4 X-Window	: X11R4, OSF/MOTIF : R1.1
10.2.5 Unix based IBM Emulator	: TN3270
10.2.6 개발 Language	: 'C' Language

## III. 결 론

현재 당사에서는 모든 제품의 개발에 있어, 기구/전자 부문 공히 CAD System을 사용하고 있으나 이에서 발생 되는 도면과 기술문서를 효율적으로 관리할 수 있는 체계의 정립 및 활용을 위한 System화의 노력은 거의 전무한 실정이었다. 이에 따라 본 연구에서는 당사에서 시급히 요구되고 있는 기술정보관리의 전산화와 설계에 관련된 각종 정보의 생성 및 제공을 설계 단말을 포함한 각종 단말에서 가능케 하여, 설계자의 설계 환경 개선을 통한 개발 납기단축 및 설계 품질 향상을 도모하고, 설계Data를 생산 부서에서도 On-Line으로 공유함으로써 설계/생산간의 문제점을 조기에 해결하여 생산 품질의 향상을 꾀하고자 하였다. 또한 개발 완료전에 CAD Data를 이용하여 E-BOM을 MMS(MRP)에 등록하여 줌으로써, 구매 및 자재부서의 원활한 업무 처리를 지원하고, Process Manage를 할 수 있는 기본 환경을 구축하였다.

본 연구에 이어 2차년도에는 기존 S/W의 보완 작업 및 생산 지원 시스템, 설계 Utility S/W 시스템, 설계 검증 시스템 등을 개발 할 예정이다.

## IV. 참 고 문 헌

1. "效率設計システム構築法", 大阪科學技術センター, 1989. 11
2. "日本 IBM 출장보고서", 규격 표준화 T/F팀, 1991. 6
3. "Engineering Data Base", 삼성 휴렛팩커드, 1991.
4. "CAD & CIM", Vol.4 No.1 (통권 13호), JAPAN
5. "Mechanical Engineering Series 10 Interfacing Manual", HP, 1990